

合肥晶合集成电路股份有限公司

“提质增效重回报” 2024 年度评估报告

暨 2025 年度行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司内在价值的认可和切实履行回报社会的责任感，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日发布了《晶合集成 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。过去一年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作。为持续夯实高质量发展根基，增强价值创造能力，公司在 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施的基础上，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

2024 年，公司围绕行动方案的战略方向，积极聚焦主营业务，持续加大研发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，公司订单充足，产能利用率持续保持高位水平，经营管理效率和运营水平不断提升。公司全年实现营业收入 924,925.23 万元，同比增长 27.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 53,284.06 万元，较上年同期增长 151.78%；实现经营性现金流量净额 276,113.13 万元，较上年同期增加 292,216.72 万元。2024 年公司主营业务毛利率为 25.48%，同比改善 4.02 个百分点。

1、重视质量管理，强化产品质量

公司始终重视质量管理体系建设，提升产品的稳定性和可靠性。2024 年度，公司主要量产平台良率均稳定在较高水平，为客户提供高性能、高良率、高可靠的晶圆代工服务，产品获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认

可，与众多客户建立了长期、紧密的合作关系。2025 年度，公司将继续以技术创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断提升产品质量，丰富技术储备，并引入先进的生产设备和技术，加强质量管理，提升产品的稳定性和可靠性。

2、优化产品结构，丰富产品线

2024 年度，公司实现主营业务收入 911,958.01 万元，从制程节点分类看，55nm、90nm、110nm、150nm 占主营业务收入的比例分别为 9.85%、47.84%、26.84%、15.46%；从应用产品分类看，DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic 占主营业务收入的比例分别为 67.50%、17.26%、8.80%、2.47%、3.76%。公司不断丰富产品种类、优化产品结构，提升毛利水平。其中，CIS 占主营业务收入的比例显著提升，已成为显示驱动芯片之外的第二大产品主轴。

2025 年度，公司将持续丰富自身产品结构及强化自身技术能力，扩大应用领域及开发高阶产品，提升产品竞争优势及多元化程度。其中，在 OLED 显示驱动芯片代工领域，公司 28nm OLED 显示驱动芯片研发进展顺利，未来将具备完整的 OLED 驱动芯片工艺平台；在电源管理芯片代工领域，公司正在进行 90-110nm 的 BCD 电源管理芯片的研发，未来公司产品将应用于更多领域；针对 AR/VR 微型显示技术，公司正在进行硅基 OLED 相关技术的开发，已与国内外领先企业展开深度合作。目前 110nm Micro OLED 芯片已成功点亮面板，产品研发进展顺利。此外，公司积极配合汽车产业链的需求，布局车用芯片市场。在汽车芯片制造能力建设上，公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证，并通过多个工艺平台的车规验证，目前 55nm 车载显示驱动芯片已量产。未来，公司平台及产品结构将日益丰富，为客户提供更加丰富的产品解决方案。

3、加大研发投入，提升核心竞争力

公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入，以保证技术和产品持续创新，提高产品市场竞争优势。2024 年，公司研发投入为 128,397.52 万元，较上年增长 21.41%，占营业收入的比例为 13.88%；公司新增专利 325 个，其中发明专利 249 个，截至 2024 年末公司累计获得专利 1,003 个。2024 年，公司 55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片工艺平台实现大批量生产、40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现小批量生产、28nm 逻辑芯片通过功能性验证、110nm Micro OLED

芯片已成功点亮面板、55nm 车载显示驱动芯片量产、新一代 110nm 加强型微控制器（110nm 嵌入式 flash）等工艺平台完成开发。

公司聚焦核心技术，紧跟传统领域与新兴市场的发展趋势，以客户需求为导向，规划和研发更丰富的工艺平台，持续进行研发投入，推进技术迭代升级。2025 年，公司在研发方面会持续投入资源，以加强公司核心技术能力，全面提升产品组合的技术竞争力。未来几年，公司重点投入的研发项目进展与达成目标如下：

序号	项目名称	研发进展	拟达到目标	具体应用前景
1	28nm 精简型高效能工艺平台	技术开发阶段	完成平台开发，包括全套低、中、高压器件，提供低功耗，高效能的元件方案供客户设计，并实现批量生产	时序控制，WiFi、射频、OLED 驱动、图像处理芯片
2	28nm 逻辑及 OLED 芯片工艺平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发，包括全套低、中、高压器件，提供大容量 SRAM，降低功耗，适应各种高端显示技术需求。	视频 SoC、图像处理 (ISP)、信号传输及视频桥接芯片、时序控制芯片、内存控制器、FPGA、CPU、高阶智能手机 OLED 屏
3	55nm OLED 显示驱动芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发及车规验证，并实现批量生产	智能手机 OLED 屏、笔记本电脑 OLED 屏
4	90nm 高阶显示驱动芯片工艺平台	产品验证阶段	开发高压组件，提高驱动能力，导入客户并实现批量生产	电子标签、电子纸等电子产品
5	110nm 高阶显示驱动芯片工艺平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发，满足车规、超低漏电等多种工艺需求，实现产品批量生产	VR 眼镜/AR 眼镜/抬头显示/辅助显示/车用 LCD 面板/仪表板/笔记本电脑
6	90nm 高阶 CMOS 图像传感器技术平台	工艺制程验证阶段	完成 90 纳米图像传感器工艺制程验证，进行车规级可靠性验证，导入客户，并实现批量生产	智能手机、安防、无人机、游戏娱乐、工业自动化等
7	110nm 高阶微控制器平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发，通过车规级可靠性验证，导入客户，实现批量生产。	智能家电、办公设备及通用型车用控制器、PC/笔记本电源等
8	90nm BCD 电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发及 AEC-Q100 车规可靠性测试，导入客户实现批量生产	接口芯片、快充协议芯片、手机电源管理芯片等
9	110nm 高压电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发，降低器件导通电阻，提高器件耐压，导入客户并实现	快充协议芯片、音频功放、消费电子电源管理芯片、储能领域电池管理 (BMS)

			批量生产	
10	150nm 电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发，提高器件耐压，达到客户器件规格需求，提升产品良率，实现产品批量生产	负载开关、DC-DC、AC-DC 转换、LED 照明、电机驱动、LDO 各式电源驱动、快充协议芯片、工控（手持电动工具充电等）手机/移动设备等低端消费电子，LED Driver，TV PMIC 等等
11	功率半导体技术平台	工艺制程验证阶段	完成功率半导体工艺平台开发，降低器件导通电阻并提高器件耐压，导入客户并实现批量生产	工业电机控制、车用电机等
12	光罩研发项目	工艺制程验证阶段	导入客户实现批量生产	芯片掩膜版

4、加强募投管理，推进募投项目建设

2023 年 5 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金净额为 97.24 亿元。截至 2024 年末，募集资金累计投入 80.63 亿元，累计投入进度 82.92%。其中，公司募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”和“补充流动资金及偿还贷款”的募集资金已按规定用途使用完毕并结项；募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”因公司期望与客户合作更加多元化的产品应用及其衍生工艺平台（如旗舰版手机主摄芯片及多光谱感光元件等），故审慎决定将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年底，以保障募投项目顺利实施；募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响，经评估该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势，公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品，将更多研发力量投向效益更好的研发项目，因此 2024 年 12 月经董事会及监事会审议，计划终止该募投项目并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，该事项尚需公司股东会审议。2025 年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募

集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

二、优化运营管理，实现降本增效

1、加强生产管理，强化资源整合

2024 年，公司通过工艺优化等手段提升生产效率，降低生产成本，实现降本增效，提升公司核心竞争力。公司智能生产线拥有高端智能制造营运管理制度及系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的产品品质。公司成功将人工智能技术全面导入研发、营运等环节，实现 AI 智造升级及全局优化。同时公司积极推动关键原辅材料和设备的国产化。公司生产集中在同一园区内，本地产业链配套较为齐全，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，且最大程度地采用国产化设备与材料，产品成本更具竞争力。2025 年，公司将持续提升精细化管理水平，加强内部生产管理与资源整合，持续优化和提升生产运营效率。

2、提高资金效率，重视应收账款管理

由于公司所处半导体设备行业具有资金密集性的特征，产品技术升级快，研发投入大，并且研发投入早于应用层面，因此公司需要将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局早于客户需求。2024 年，公司通过优化库存、加快新产品在客户端的验收、加快回款等举措，提高资金使用效率。同时，公司严格执行应收账款相关管理制度，完善内部控制，定期对客户信用重新评估，并积极采取多种举措促进应收账款回笼，目前公司主要客户的应收账款状态良好。2025 年公司将持续提高资金使用效率并优化应收账款管控措施，进一步提高运营效率、增加经营活动现金流入。

3、重视人才队伍建设，构建义利共生的人才战略

公司重视人才队伍建设，不断引进和培养各方面的人才。截至 2024 年底，公司拥有研发技术人员 1,866 名，占员工总人数比例为 34.89%。研发人员中硕士及以上学历占比为 65.22%，为公司的高质量发展提供坚实的人才保障。公司高度重视员工培训，2024 年通过内部培训、在线学习平台、外派训练等方式开展包括专业类、管理类、潜能开发类等的特色培训活动，为员工提供学习资源，促

进员工与公司共同发展。2025 年，公司将继续引进和培养各方面的人才，吸纳全球高端人才，优化人才结构。同时，公司将继续优化现有培训体系，创新培训形式，加强团队分享学习，形成有效的人才培养和成长机制，发展高效协同的企业文化。

公司通过员工持股平台、股权激励、绩效奖励等措施持续加强团队稳定性。2025 年 3 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，制定了与公司经营发展相适应的公司层面和个人层面的绩效考核指标并严格执行，有效保证公司管理层和核心员工团队的稳定性，该议案尚需公司股东会审议。未来公司将持续健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

三、强化公司治理体系，构筑坚实发展基石

1、完善公司治理体系，坚持规范运作

2024 年，公司顺利完成了董事会、监事会及经理层换届选举和聘任工作，确保董事会连续高效运行。同时，公司持续完善内部控制体系制度，紧密跟踪相关法律法规的变化，完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及专门委员会工作细则等治理制度的制定、修订工作，确保公司制度严格符合当下法律层面的合规要求。公司围绕基本内部制度，建立起更为精细化的流程和管理机制，有效防范了经营及内部控制风险。同时，内部审计部门独立开展工作，定期对公司财务收支、内部控制、重大项目等进行审计，并充分发挥监事会的监督职能，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，保障公司规范运作。2025 年，公司将持续加强内控管理，根据《公司法》等相关法律、法规及监管部门的配套规定，进一步对公司治理结构及《公司章程》等相关制度进行修改、完善，推动公司健康持续发展。

2、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享约束

2024 年，公司与大股东及公司董监高等“关键少数”人员保持紧密沟通，通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，

持续提升“关键少数”履职能力和风险意识，确保规范履职。2025 年度，公司将继续与公司大股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。

2025 年，公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高级管理人员薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳定发展。

3、为独董履职创造良好环境，强化监督机制

2024 年，公司深入落实独立董事制度改革要求，严格按照《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的要求提名和选举第二届董事会独立董事；并且修订了《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》，公司严格遵循监管部门对独立董事履职的各项规定与要求，建立了常态化的沟通机制，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事在每年不少于 15 天的工作日能高效地开展工作。独立董事凭借其专业优势与独立判断能力，积极参与董事会讨论并提出专业意见，为公司科学决策提供了重要参考。2025 年，公司将定期评估独立董事的独立性，并继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

四、提升 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司董事会高度重视社会责任对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。截至目前，公司已连续 3 年公开披露可持续发展报告，向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。公司参考国际、国内可持续发展相关标准，开展可持续发展实质性议题识别与评估，判定 ESG 风险，努力落实环保减排及资源再利用方针，营造包容开放的职场环境，完善内部控制及风险管理机制，充分将 ESG

及可持续发展融入常态化工作与管理。

2025 年，公司将持续秉承“提供对客户最有价值的产品、建设最卓越的标杆企业、努力促进社会与产业的进步”的使命，发布高质量 ESG 报告，并持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

五、提高信息披露水平，加强投资者沟通

2024 年，公司高度重视投资者关系管理，组织回答“上证 e 互动”问题 34 项；定期组织召开业绩说明会，召开网络互动业绩说明会 3 场，向市场及时传递经营信息和公司价值；积极组织机构调研，发布投资者活动记录表 9 次，及时向投资者传递公司经营情况并分享公司动态。同时，采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式，通过安排专人接听投资者热线，电话、电子邮箱渠道回答投资者问题 216 次。与投资者及时进行沟通、交流，提高了公司透明度和诚信度，建立并维护投资者与公司的长期信任关系，树立公司良好的资本市场形象。公司高度重视信息披露工作，致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

2025 年度，公司将召开不少于 3 次业绩说明会，通过视频或文字直播、定期报告、企业社会责任报告等形式，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况；公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。

六、积极实施股份回购，重视投资者回报

公司董事会于 2024 年 12 月，审议通过了《公司市值管理制度》。公司将综合运用多种方式，进一步加强市值管理，提升公司的投资价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，维护公司及广大投资者的合法权益。

1、实施股份回购

2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。回购资金总额不低于

人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 100,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 25.26 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 3 月 5 日，公司完成回购，累计回购公司股份 62,088,500 股，占公司总股本的 3.09%，回购成交的最高价为 15.31 元/股，回购最低价为 12.97 元/股，回购均价 14.36 元/股，支付的资金总额为人民币 891,677,308.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、股东分红回报规划

公司坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。在符合利润分配条件的前提下，结合公司实际经营情况及未来发展规划，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果，增强投资者对公司发展的信心。公司 2024 年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利 19,440.47 万元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 36.48%。公司将在 2024 年年度股东大会审议通过上述方案后，积极推进 2024 年度利润分配方案的实施。

3、稳定股价预案

为保持公司上市后股价稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员承诺自公司首次公开发行上市之日起三年（36 个月）内，如非因不可抗力因素所致，在公司 A 股股票收盘价格出现连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值的条件满足时，将依据法律法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响公司上市条件的前提下实施稳定股价的措施。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年4月18日